

공정 Process

01



CAD/CAM

기판의 내/외층 회로를 설계한 후 작업 조건에 맞게 DATA를 가공한다.

02



FLIM PLOTTING

EDIT가 끝난 DATA를 FILM으로 출력하고 검토한다.

03



내층 이미지

다층 PCB의 내부 도체 패턴층을 형성한다.

04



내층 검사

내층의 IMAGE상태를 육안 및 장비 (AOI,VRS)를 사용하여 검사 실시

05



OXIDE

PRESS시 층간 밀착력 향상을 위한 표면처리

06



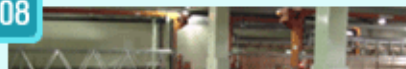
LAY-UP & PRESS

MLB 제조를 위해 예비 적층된 제품을 열과 압력을 가하여 내외층을 형성시키고 적절한 PROCESS에 의해 안정된 경화상태를 가진 MASS-LAM을 형성 시킨다.

07



08





DRILLING

부품삽입 및 층간 전기 도통을 위하여 기계적, 또는 Laser로 Hole을 가공하는 공정



도금

Drill가공된 Hole속의 도체층을 도통시키고, 부품 Hole에 대한 납땜성을 부여하기 위해 도금한다.

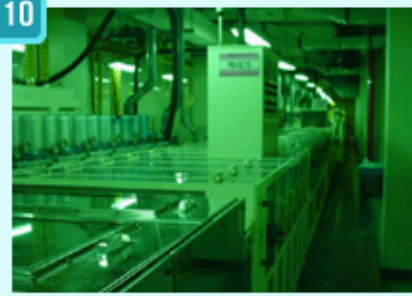
09



외층 이미지

동박 표면에 도포 또는 밀착된 RESIST를 UV 빛에 의해 중합 반응을 일으켜 원하는 회로를 형성하는 공정

10



외층 부식

전기적 회로를 형성하기 위해 불필요한 동박을 제거해 준다.

11



외층 검사

빛을 조사하여 반사된 부분과 DATA를 비교하여 회로의 하자를 검사

12



PSR 인쇄 및 Marking

B/D의 표면 보호와 회로사이의 Short를 방지하기 위해 Solder resist ink를 도포한 후 부품실장위치나 기호를 표시한다.

13



14





표면처리

표면 산화 방지 및 Soldering성을 확보하기 위해
기판 표면에 유기화합물을 도포하거나 동 표면을
Nickel, Sn/Pb, 금등으로 도금해 준다.



ROUTING

PNL단위로 투입된 제품을 출하규
격단위(KIT)로 가공해준다.



BBT

전기 도통시험을 통하여 기판의 전도성이나 저항
치의 높낮이를 Check함으로써 회로의 결손 여부
를 알 수 있으며, 전기적 신뢰성을 확보한다.



최종 출하 검사

최종검사: 완성된 제품이 규격에 적
합한가의 여부를 검사

출하검사: 최종검사 후 부적합품이
고객으로 인도되지 않도록 출하전
검사



포장

최종출하되는 제품을 파손에 주의하여 단위별 포
장한다.